



関係各位

ISSM 組織委員会委員長
株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター
代表取締役会長兼社長 齋藤 昇三
ISSM 組織委員会副委員長
アトナープ株式会社
アドバイザー 井上 修一
ISSM 運営委員会委員長
東芝ナノアナリシス株式会社
技師長 嶋崎 綾子

第 30 回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2024」協賛募金のお願いについて

拝啓 ますますご清祥の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は、ISSM(半導体生産技術国際シンポジウム)にご厚情を賜りまして誠に有難うございます。

ISSM は 1992 年発足以来、皆様のご支援を賜り、これまでの 29 回の実績から半導体生産技術に関する最も重要な国際会議の一つとして認知をいただき、半導体生産におけるメジャー会議としての位置づけを確立しております。

昨今、ISSM のテーマである半導体製造技術は、「作る技術」から「使う技術」へのシフトが益々重要となってきました。半導体製造技術全体を広く捉えて技術を評価し選択していくことが必要な今、ISSM は半導体製造全般の技術を網羅している特徴を活かし、異なる技術分野を統合化する体系的なアプローチを評価できる唯一の国際会議として、半導体製造の発展に一層寄与していきたいと考えます。

技術面に加えまして、SCM 軸での地勢的な原材料の調達・リユース課題や、最終ユーザーからの脱炭素世界に準じた生産技術の対応課題なども、新たな変化として浸透しております。

第 30 回を迎える、ISSM2024 は、半導体生産技術の新たな課題にむけて、半導体産業界の有益な協調を推し進め、延いては半導体産業の新たな飛躍に資すること、また半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを旨として、2024 年 12 月 9 日(月)～10 日(火)に、KFC ホール(東京・両国)での開催を予定しております。

シンポジウムの開催は参加費にて運営されることが本来の姿と考え、参加者にとって魅力ある企画の推進に努めておりますが、半導体の将来を担う若手技術者並びに学生の参加を積極的に募るには、低めの参加費、もしくは無料の設定も必要と考えております。経費の大幅な節減を行いましても、参加費のみでシンポジウムを開催することは至難な状況です。

ISSM2024 に何卒、ご支援を頂きたく、ご寄付(協賛募金)にご協力賜りますようお願い申し上げます。なお、講演論文の募集につきましてもあらためましてご依頼を申し上げますので、重ねましてよろしく願い申し上げます。

敬 具

ISSM2024 大綱

1. 会議の名称

(和文名称) 第30回半導体生産技術国際シンポジウム 2024

(英文名称) International Symposium on Semiconductor Manufacturing 2024

(略称) ISSM2024

2. 支援機関などの名称(予定)

Co-sponsored by:

IEEE Electron Devices Society

Minimal Fab

Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ)

Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA)

Endorsement by:

The Japan Society of Applied Physics

3. 会期と開催地(予定)

(1)会期:2024年12月9日(月)ー10日(火)

(2)開催地:KFC ホール(東京・両国)

4. ISSM2024 会議の概要

(ア) 会議日程 2024年12月9日(月)ー10日(火)

(イ) 会議内容(予定)

① キーノートセッション(基調講演)

② ハイライトセッション

③ オーラルプレゼンテーションセッション(一般講演)

④ インターラクティブ・ポスターセッション

⑤ チュートリアルセッション

(ウ) 会議の主題:半導体生産技術

Fab Management

- ・工場設計および搬送自動化(FD)
- ・製造ラインの戦略及び運営管理(MS)
- ・生産管理および制御(MC)
- ・環境・安全・健康(ES)
- ・工場データ管理(ID)

Process Integration

- ・プロセスおよび材料の最適化(PO)
- ・歩留まり向上(YE)
- ・汚染制御及びウルトラクリーンテクノロジー(UC)
- ・プロセス制御・モニタリング(PC)
- ・製造装置・測定装置(PE)
- ・生産性設計(DM)
- ・新規デバイス向け製造技術(VD)

3D, Chiplets & Advanced Packaging

- ・3D、チップレット、先端パッケージ技術(TP)

(エ) 参加予定国:日本, 米国, 欧州諸国, アジア諸国, その他

(オ) 参加予定者

日本、欧米、アジアなどから 250 名

(カ) 会議公用語

講演	英語
印刷物	英語

ISSM2024 委員会組織 (敬称略)

組織委員会

組織委員会	氏名	所属機関名	部署	役職名
組織委員長	齋藤 昇三	株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター		代表取締役会長兼社長
組織副委員長	井上 修一	アトナーブ株式会社		アドバイザー
	和田 純一	キオクシア株式会社	メモリ技術研究所 プロセス技術研究開発センター	センター長
	井上 道弘	国立研究開発法人産業技術総合研究所		イノベーションコーディネータ
	木村 徹	JSR株式会社		電子材料事業部長
	奥野 泰利	株式会社SCREENホールディングス		執行役員 特命担当
	岩元 勇人	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社		第2/4研究部門 部門長
	佐々木 智幸	タワー パートナース セミコンダクター株式会社		最高技術責任者 (CTO) 兼 プロセステクノロジーセンター所長
	瀬川 澄江	東京エレクトロン株式会社	コーポレートイノベーション本部	執行役員 本部長代理
	加藤 浩朗	東芝デバイス&ストレージ株式会社	半導体事業部 先端半導体デバイス開発センター 先端半導体デバイス第一開発部	シニアマネジャー
	多留谷 政良	三菱電機株式会社	パワーデバイス製作所	主管技師長
	小池 淳義	Rapidus株式会社		代表取締役社長
運営委員長	嶋崎 綾子	東芝ナノアナリス株式会社		技師長

運営委員会

運営委員会	氏名	所属機関名	部署	役職名
運営委員長	嶋崎 綾子	東芝ナノアナリス株式会社		技師長
	小澤 克敏	オムロン株式会社	インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 企画室 IoTプロジェクト	部長
	姜 帥現	キオクシア株式会社	先端技術研究所 デバイス・プロセス研究開発センター 先端プロセス研究開発部	部長
	内野 敏幸			
	奥野 泰利	株式会社SCREENホールディングス		執行役員 特命担当
	浜島 雅彦	SEMIジャパン		代表取締役社長
	岩元 勇人	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社		第2/4研究部門 部門長
	佐々木 智幸	タワー パートナース セミコンダクター株式会社		最高技術責任者 (CTO) 兼 プロセステクノロジーセンター所長
	売賀 賢介	株式会社デュラシステムズ		代表取締役社長
	守屋 剛	東京エレクトロン株式会社	Corporate Innovation本部 デジタルデザインセン ター 先端技術開発二部	部長
会計委員長	加藤 浩朗	東芝デバイス&ストレージ株式会社	半導体事業部 先端半導体デバイス開発センター 先 端半導体デバイス第一開発部	シニアマネジャー
	中馬 宏之	日清紡ホールディングス		シニアアドバイザー
	赤堀 浩史	Rapidus株式会社		
	渡部 潔	一般社団法人日本半導体製造装置協会		専務理事
	服部 毅	Hattori Consulting		国際ジャーナリスト テクニカルライター
	多留谷 政良	三菱電機株式会社	パワーデバイス製作所	主管技師長
	岡本 和也	大阪大学/日本工業大学	大阪大学 招聘教授 ナノデザインセンター、 日本工業大学 技術経営研究科 技術経営専攻	教授
	森 啓之	ルネサス エレクトロニクス株式会社	前工程生産技術統括部 プロセス加工技術部	部長兼リソグラフィプロセス技術課課長
	島根 誉	ローム株式会社	WP生産本部 WP統括	統括部長

プログラム委員会

プログラム委員会				
委員長	今井 伸一	株式会社日立ハイテク	事業開発本部 Business Development Div.	主管技師 工学博士
委員長代行	嶋崎 綾子	東芝アナリティクス株式会社		技師長
幹事会委員	加藤 凡典	イー・アイ・ティ		代表取締役
幹事会委員	南百瀬 勇	オムロン株式会社	インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー アドバンスドソリューション事業本部	マネージャー
幹事会委員	松川 和人	株式会社SUMCO	生産技術本部 副本部長 マーケティング技術部	常務執行役員 部長
	山田 裕貴	JX金属株式会社	磯原工場 製品開発センター 半導体Gr.	
IEEE TSM Publication Chair	守屋 剛	東京エレクトロン株式会社	Corporate Innovation本部 デジタルデザインセンター 先端技術開発二部	部長
	水野 晋介	アプライドマテリアルズジャパン株式会社	PDCプロダクトマネージメント	マネージャー
	三宅 賢治	オフィス三宅		
	新保 正博	オン・セミコンダクター	技術統括部 プロセス技術開発部	主任技術員
	井ノ本 実	キオクシア株式会社	先端技術研究所AI・システム研究開発センター AI・DX技術研究開発部	
	中川 聡子	グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社	技術部基盤技術グループ	主事
	青木 正身	ケーエルイー・テンコール株式会社	プロセス・コントロール・ソリューションズ	アジア・リージョナル・ディレクター
	川上 峰規	JSR株式会社	電子材料事業部 リソグラフィ材料部	部長
	久松 貴将	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社	長崎TEC MIS製品部門 デバイス技術1部 技術2課	統括課長
	安井 孝俊	タワー パートナース セミコンダクター株式会社	プロセステクノロジーセンター プロセス技術開発部 イールドマネジメント開発課	主幹技師
	有馬 遼佳	筑波大学	システム情報系 社会工学科 ファカルティシステム情報工学研究科	講師
	大見 俊一郎	東京工業大学	工学院 電気電子系	准教授
	小西 敏雄	株式会社トッパンフォトマスク	事業戦略部	課長
	井上 弘之	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社	美浦ウエハーファブ プロダクトエンジニアリンググループ	TI上級主任技師 シニアプロフェッショナル
	根本 和典	Hitachi High Technologies America, Inc.	Corporate Strategy	VP
	松本 剛征	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	三重工場 生産技術部	
	渡邊 健二	Rapidus株式会社	デバイス技術部	シニアエンジニア
	横田 和樹	ルネサス エレクトロニクス株式会社	生産本部 デバイス開発統括部 プロセス技術部 プロセス技術第二課	課長
	竹井 祥司	ローム株式会社	LSI製造部 NVM技術課	技術員

eMDC (e-Manufacturing & Design Collaboration Conference)/TSIA 協力メンバー

Name	Affiliation
Dr. Nicky C.C. Lu	Chairman & CEO, Etron Technology, Inc./Managing Board Director, TSIA
Dr. TY Wu	President, TSIA
Ms. Celia Shih	TSIA
Mr. Thomas Chen	Tsmc
Mr. Robert Chien	Tsmc
Dr. C. Hsu	Tsmc
Prof. SC Chang	National Taiwan University
Prof. Argon Chen	National Taiwan University

【ISSM2024 協賛金特典内容】

種別	プラチナ	ゴールド	シルバー	ブロンズ	レセプション	ストラップ
募集上限	—	—	—	—	2	1
協賛金(税別)	¥800,000	¥600,000	¥400,000	¥200,000	¥400,000	¥200,000
ISSM 参加						
ISSM2024への無料参加人数						
ISSM2024参加費 (予定)						
一般参加 (早期申込割引) 40,000円	6	4	2	1	1	1
一般参加 (通常・当日) 50,000円						
学生 (予稿集無し) 無料						
学生 (予稿集有り) 3,000円						
Visibility						
ISSM2024ウェブサイト (ロゴから企業HPへリンク)	上段	中段 (上)	中段 (下)	下段	下段	下段
キーノート前に1分間のPR動画投影 (希望ベース)	有	有	無	無	無	無
予稿集にロゴ掲載、ホームページへリンク	有	有	有	有	有	有
インターバルスクリーン上にロゴを表示	有	有	有	有	有	有
会場ポスターにロゴを表示	有	有	有	有	有	有
レセプション会場にロゴを表示	無	無	無	無	有	無
レセプションでのスピーチ	無	無	無	無	有	無
ストラップに企業名を表示	無	無	無	無	無	有
テーブルトップ展示						
展示をご希望の場合下記をご用意いたします。 テーブル1800W×450D×720H バックパネル (3つ折) 1800W×1800H 椅子1脚 ・電源(100V500W)をご希望の場合は、 5,500円 (税込) の追加料金となります	有	有	有	有	無	無
展示期間: 12月9日、10日 設営: 12/9朝、撤去: 12/10午後						

※テーブルトップ展示・ポスターへのロゴ掲載は 10 月末までが特典お申込みの期限となります。

■ISSM 事務局

株式会社セミコンダクタポータル

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-4 アーバン虎ノ門ビル 6F

Tel: 03-6807-3970 Fax: 03-6807-3960

E-mail: issm_2024@semiconportal.com